附件2：参会回执

**工业软件基础科学和共性技术研讨会参会回执**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 工作单位 |  |
| 邮 箱 |  |
| 手机号 |  | 职称/职务 | 学生代表请填写“学生” |
| 住宿要求 | 仅需填写房型和房间数(例如：大床房1间, 标准间1间),会务组将根据提交回执的先后顺序安排房间 |
| 是否做分会场报告 | 会务组将依据参会人数及会场条件安排若干分会场报告。如果您希望做分会场报告， 请在下面填写“是”，会务组会第一时间联系您。  |

请将此回执（或上述信息文本）发送至邮箱：indsoft2023@hebut.edu.cn